

株式会社 アルバック

2026年6月期 第2四半期 決算説明資料

2025年7月～2025年12月

2026年2月10日

将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**
本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・ディスプレイ・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
- **数字の処理について**
本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。
- **品目別の各数値について**
管理上の数値ベースで掲載しております。

ULVAC

■ 2026年6月期上期 連結業績概要

- 受注高は半導体・ディスプレイ等の増加により、計画比・前年同期比を上回る
- 売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地

■ 中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

- 成長戦略：**半導体電子の成長加速**
レアアース磁石関連ビジネスによる事業拡大の機会到来
- 事業改革・生産改革：迅速に推進中

■ 2026年6月期 業績予想

- 受注高予測を **2,800**億円へ上方修正、過去2番目に高い受注水準
- AI関連ビジネス牽引：半導体電子受注高予測は過去最高水準 **940**億円

サマリーからご説明します。

まず一つ目、2026年6月期上期の業績についてです。

受注高は半導体・ディスプレイなどの増加により、計画比・前年同期比を上回る結果となりました。
売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地しました。

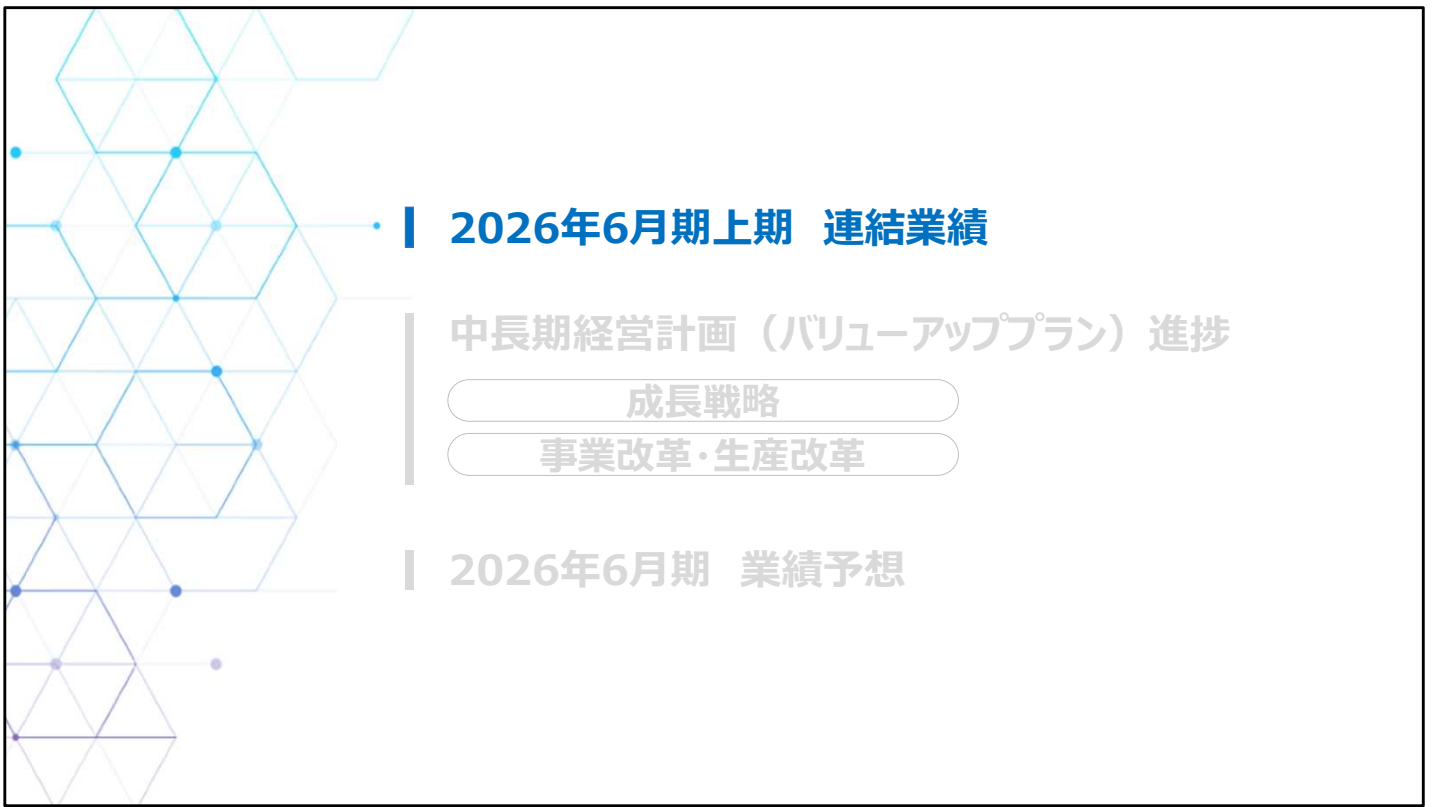
次に二つ目、バリューアッププランの進捗についてです。成長戦略についてはAIの活用に伴う真空応用領域の拡大が見えてきています。

また、レアアース磁石関連ビジネスによる事業拡大の機会が到来しています。
事業改革・生産改革などの取り組みは、迅速に推進中です。

そして三つ目、今期の業績予想と今後の展開についてですが、このたび受注高予測を期初計画の2,500億円から2800億円に上方修正しました。これは過去2番目に高い水準です。

中でも、AI関連ビジネスであるロジック・メモリ・パッケージングの半導体電子がけん引し、半導体電子受注高予測は過去最高水準の940億円を見込んでおります。

また、次なる成長が期待できるレアアース磁石関連ビジネスによる事業拡大の機会が到来しています。



2026年6月期上期の業績概要について、ご説明します。

2026年6月期上期 連結業績概要

- ▶ 受注高は半導体・ディスプレイ等の増加により、計画比・前年同期比を上回る
- ▶ 売上高・各利益項目は、概ね計画通りに着地

【単位：億円】	2025/6期						2026/6期							
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	上期					
									計画	実績	計画比	前年同期比		
受注高	509	655	1,164	475	617	2,256	604	767	1,200	1,371	+171	+14%	+207	+18%
売上高	610	739	1,349	529	635	2,512	527	712	1,155	1,239	+84	+7%	-110	-8%
売上総利益	191	238	429	176	193	799	157	207	355	364	+9	+2%	-66	-15%
率	31.3%	32.2%	31.8%	33.3%	30.5%	31.8%	29.7%	29.1%	30.7%	29.4%	-1.4pt	-	-2.5pt	-
販管費	134	142	276	122	136	533	134	145	265	279	+14	+5%	+3	+1%
営業利益	58	96	153	54	58	265	23	62	90	85	-5	-6%	-69	-45%
率	9.4%	13.0%	11.4%	10.2%	9.1%	10.6%	4.3%	8.7%	7.8%	6.8%	-1.0pt	-	-4.6pt	-
経常利益	69	92	161	61	65	286	25	67	90	92	+2	+2%	-69	-43%
率	11.3%	12.4%	11.9%	11.5%	10.2%	11.4%	4.7%	9.4%	7.8%	7.4%	-0.4pt	-	-4.5pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37	67	104	27	36	167	17	45	65	62	-3	-5%	-42	-40%
率	6.1%	9.0%	7.7%	5.1%	5.6%	6.6%	3.2%	6.4%	5.6%	5.0%	-0.6pt	-	-2.7pt	-

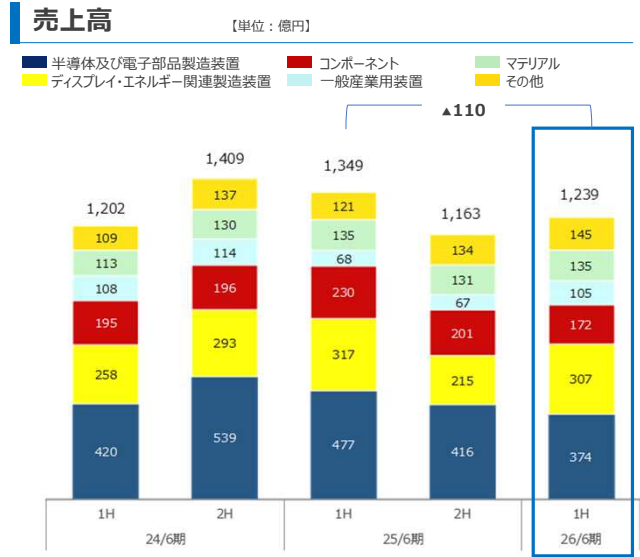
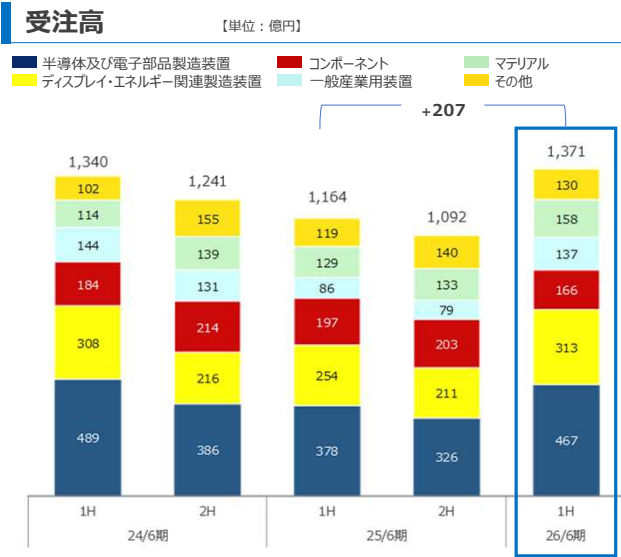
26年6月期上期の業績概要です。

受注高は半導体・ディスプレイなどの増加により、1,371億円となり、上期計画の1,200億円を171億円上回る結果となりました。

売上高については、1,239億円となり上期計画1,155億円を84億円上回る結果となりました。各利益項目は概ね計画通りの着地となっています。

受注高・売上高実績（半期推移）

- › 受注高：半導体・ディスプレイ案件投資等により、前年同期比+207億円増加
- › 売上高：半導体電子の構成比が一時的に低下も、概ね計画通りの着地



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

品目別受注高・売上高実績の半期推移です。

左側グラフ、受注高は、下段青色の半導体電子において、主にロジック・パッケージング関連が好調に推移し、また黄色のディスプレイ関連投資が増えたことにより、前年同期比で207億円増加し、1,371億円となりました。

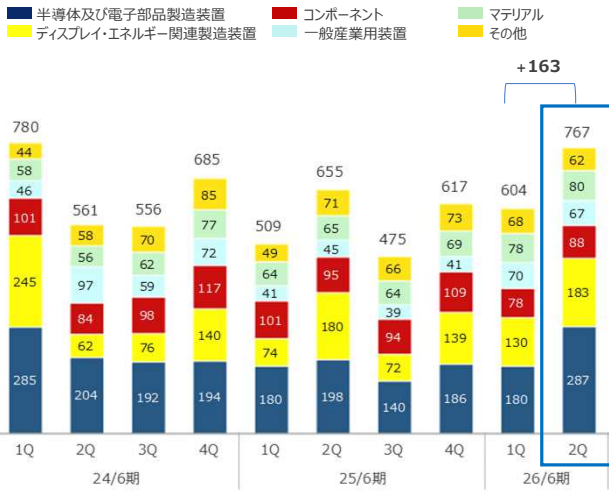
一方、右側グラフ、売上高は、パワーデバイスなどの投資減速により半導体電子の構成比が一時的に低下していますが、全体では概ね計画通りの着地となりました。

受注高・売上高実績（四半期推移）

- › 受注高：半導体・ディスプレイ案件投資等により、前1Q比+163億円増加
- › 売上高：下期からの前倒し計上等もあり、全品目で前1Q比増加

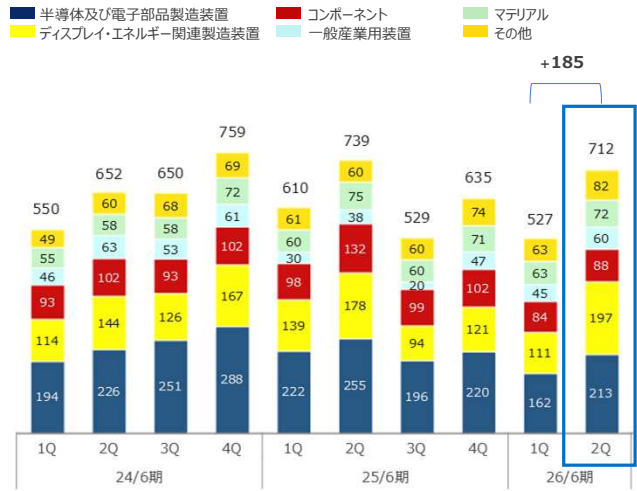
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

品目別受注高・売上高実績の四半期推移です。

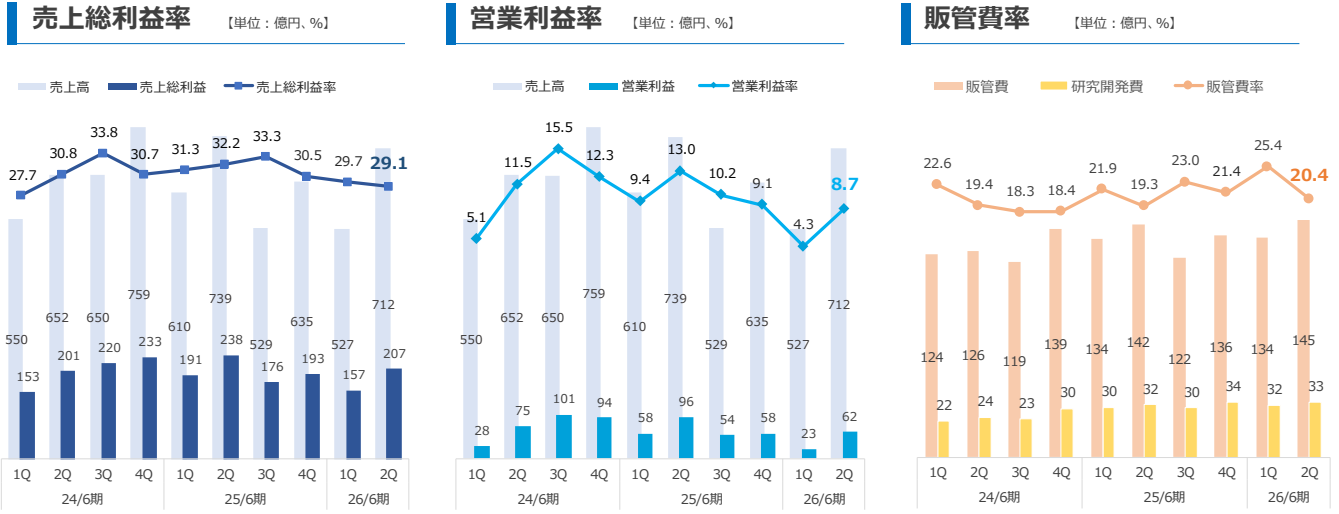
左側グラフ、2Qの受注高は、前1Q比で163億円増加し、767億円となりました。

特に、下段青色の半導体電子において、主にロジック・パッケージング関連が好調に推移し、黄色のディスプレイ関連の投資も増えました。

右側グラフ、2Qの売上高は、下期からの前倒し計上等もあり、全品目で前1Q比増加しています。

利益率推移

- › 売上総利益率：一時的な製品ミックス変化で前1Q比低下も、下期の半導体関連売上増加等で改善見込み
- › 営業利益率：2Q売上高増加により販管費率が低下し、営業利益率改善



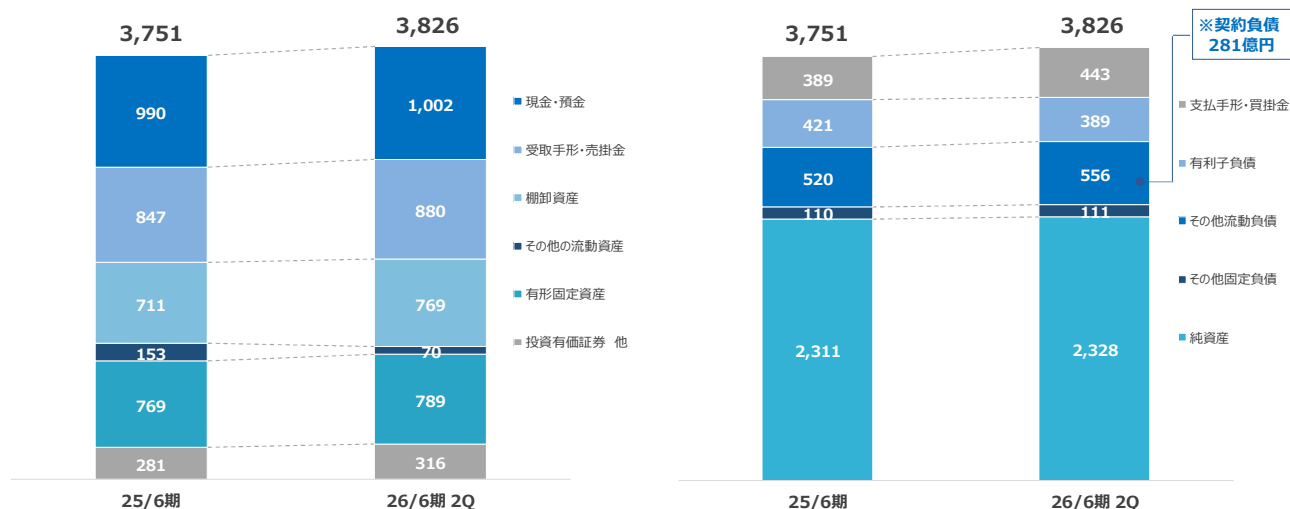
続きまして、利益率の推移です。

左のグラフの売上総利益率についてです。
 2Qの売上総利益率は、一時的な製品ミックス変化によって前1Q比で0.6ポイント低下し、29.1%となりましたが、下期の半導体関連売上増加などで、3Q以降から改善を見込んでいます。

次に真ん中のグラフ、営業利益率についてですが、2Q売上高増加により販管費率が低下し、営業利益率は前1Q比4.4ポイント改善し、8.7%となりました。

資産 [単位：億円]

負債・純資産 [単位：億円]



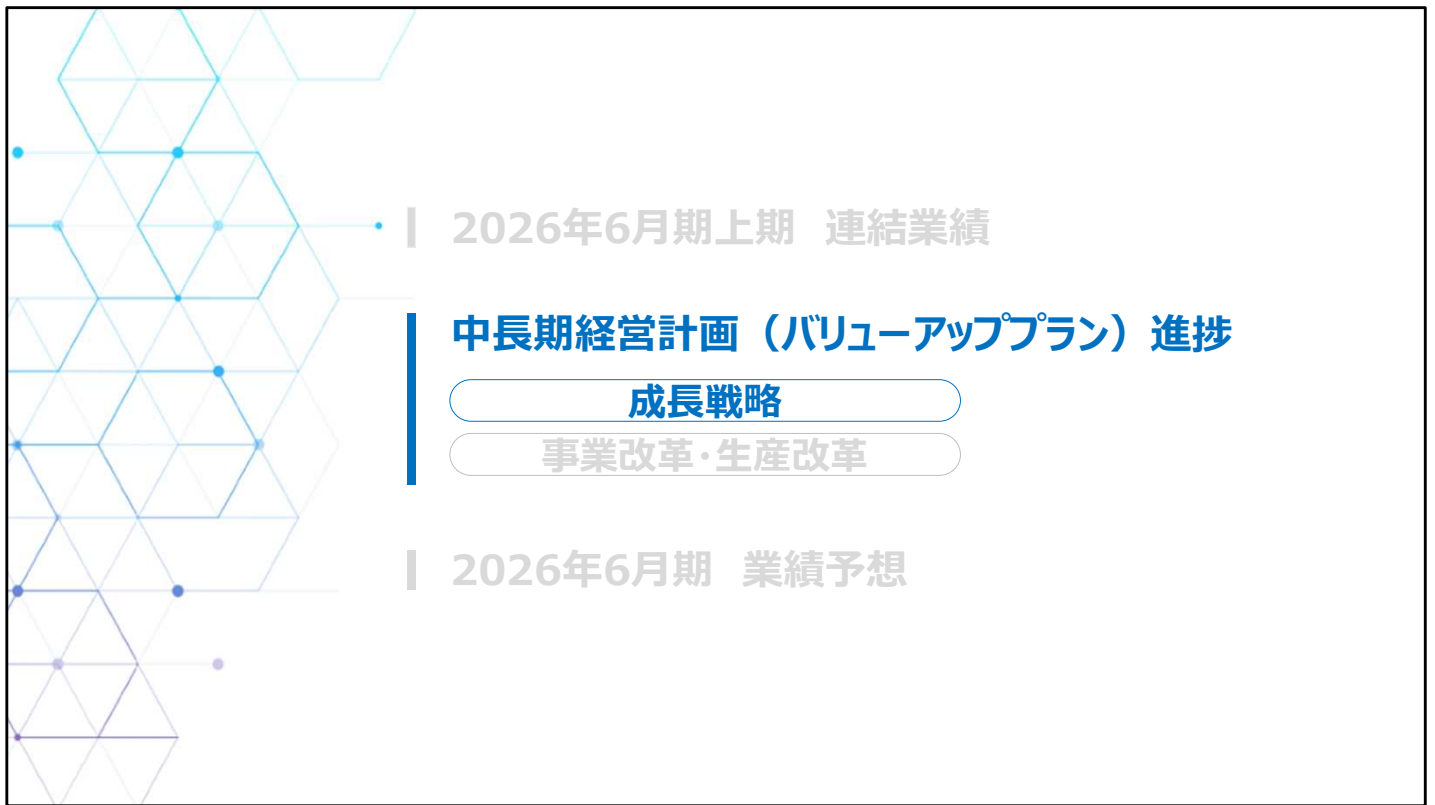
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

こちらは、2Q時点のバランスシートの状況です。

左側の資産については、ビジネス拡大に伴い売掛金、棚卸資産などが増加し、25年6月末比で75億円増加の3,826億円となりました。

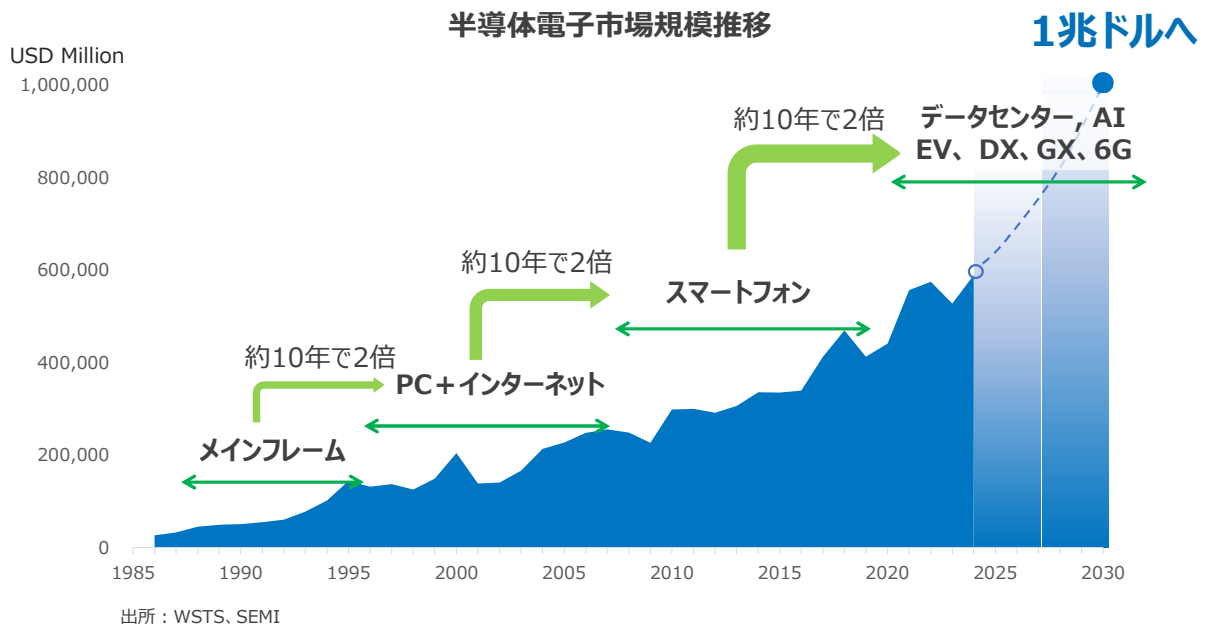
右側の負債・純資産につきましては、有利子負債など減少していますが、ビジネス拡大に伴い、買掛金・契約負債などが増加しています。

なお、2Q末の自己資本比率は59.0%となっております。

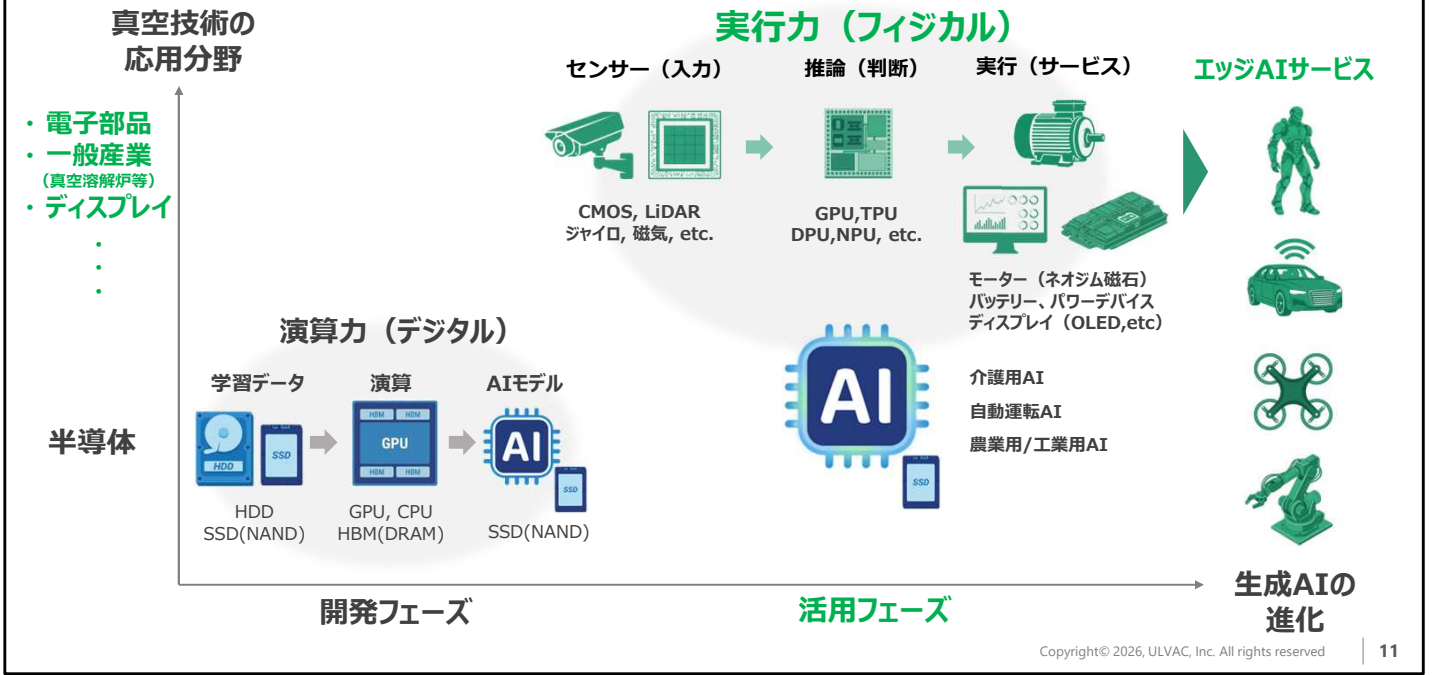


今期から2031年までの6年間、中長期計画であるバリューアッププランをスタートさせました。これは経営資源の最適化を図り、半導体電子に商品ポートフォリオを集中させ、高い成長と高い利益率を達成することで企業価値を高めていくことを狙ったものです。

それでは、この成長戦略の進捗について説明いたします。



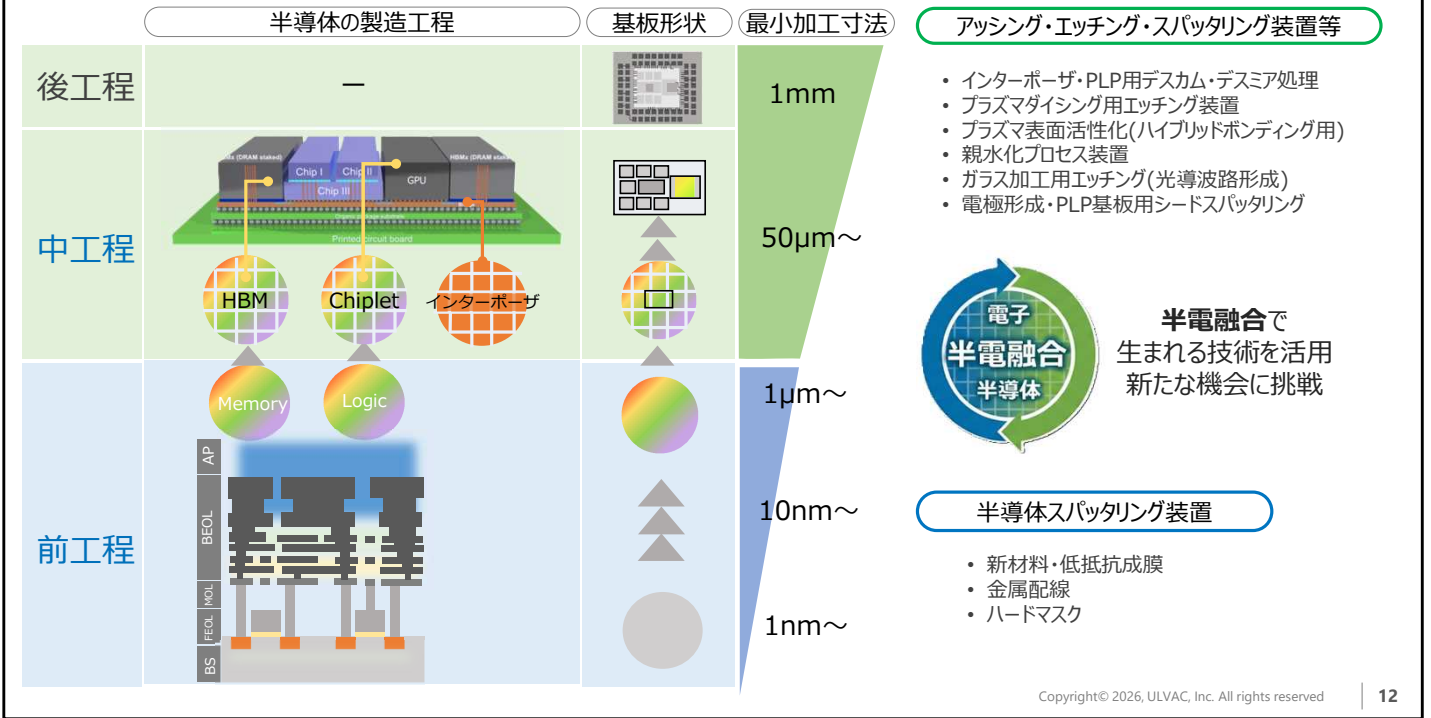
成長戦略で注力する半導体電子市場はAIを中心に市場は成長し、2030年には1兆ドル市場規模に達するものと予想されます。



この中でAIについて申し上げますと、ここ数年間、AIは演算力、GPU、HBM、CPUといったチップの高性能化、量産化に多くの投資が行われ、おかげで当社も大きく成長することができました。

AIの演算以外にも、これらフィジカルAIの領域へ装置を提供しています。今後、いたるところで生活や仕事にAIが使われるようになり、また、センサー、モーター、バッテリー、特にロボットについては、すべてバッテリーが使われます。

これらバッテリー、パワーデバイス等に加え、色々なものを映すためのディスプレイほか、当社は広い装置群を持っています。フィジカルAIの領域、新しい市場が我々の前に展開してきており、黄金期を迎えようとしています。

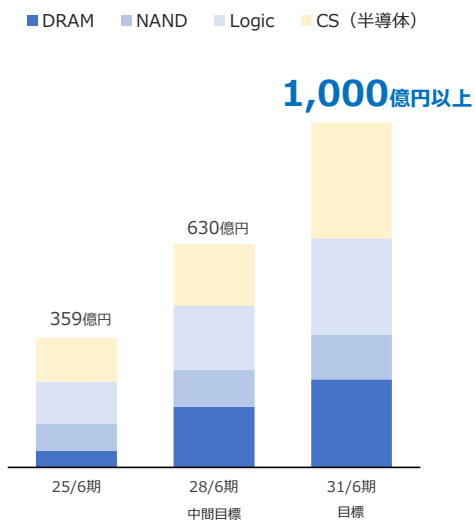


Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

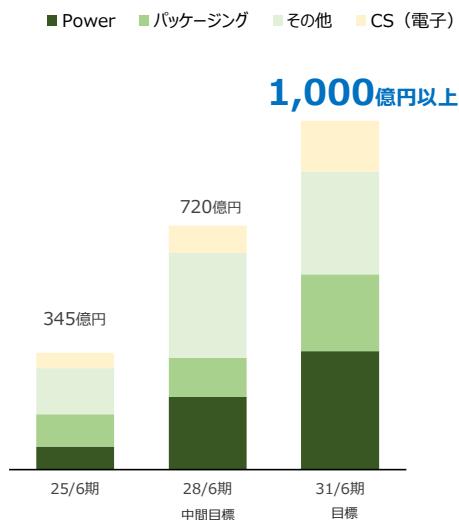
青色の前工程、中工程と記載していますが、前工程と言われるところは従来の半導体事業の分野で半導体のスパッタリング装置が使われています。さらに、この中工程のところにも沢山の装置が使われております。

当社は、半導体電子機器にの両方に装置群を持っており、半導体と電子機器の融合が行われることで、装置群がさらに広がっていきます。

半導体



電子



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体・電子分野の目標は、2031年6月期までに、半導体の領域で1,000億円、電子の領域でも同じように1,000億円の受注目標を掲げており、6年間で2,000億円の受注を目指しています。

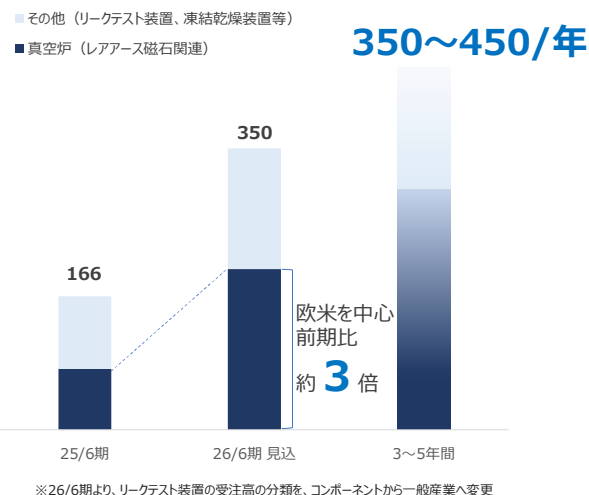
1年目（2026年6月期）にして、ほぼ半分の受注が達成できるという見通しです。

サプライチェーン多角化による生産拡大への期待



● 既存顧客
● 潜在顧客

一般産業受注高 【単位：億円】



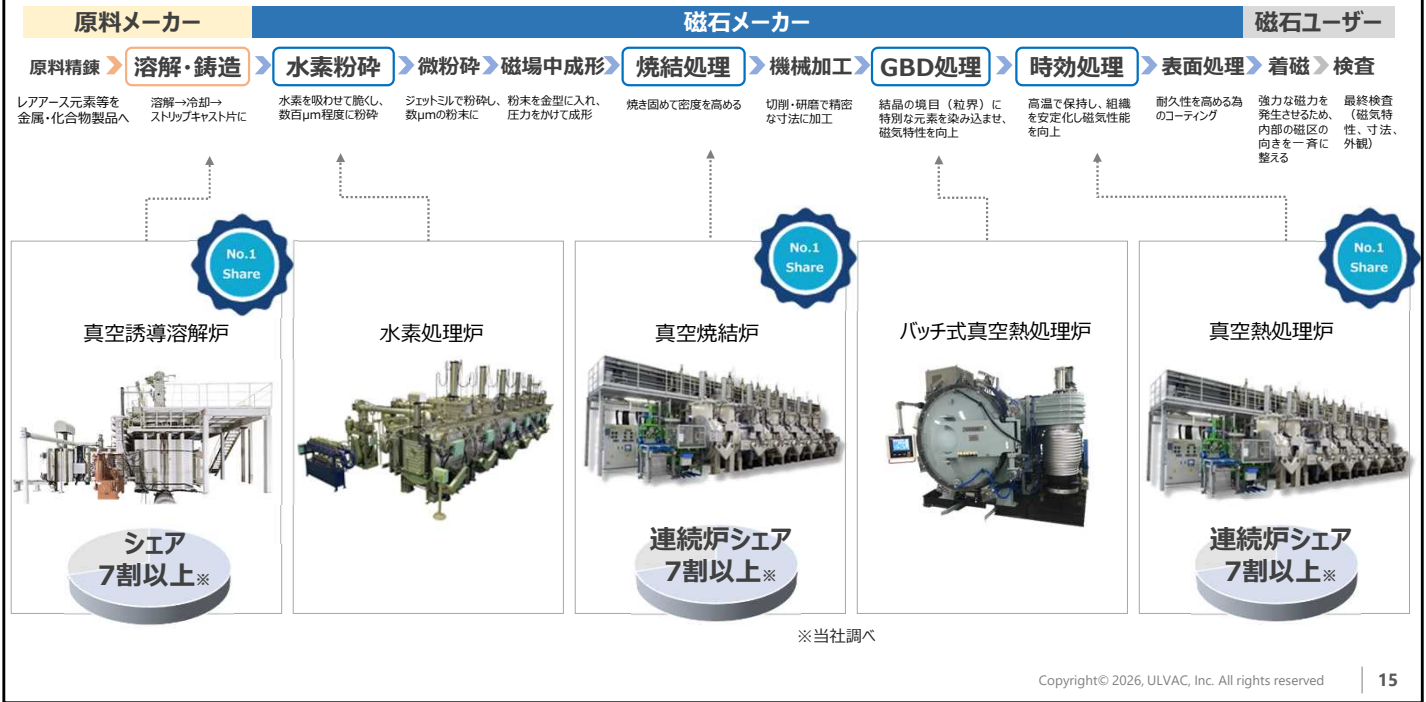
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

14

当社は、レアアースを鉱山から掘り出し、溶解から粉を生成し、さらにそれを磁石にするまでの工程において大きなビジネスを持っています。

左側の世界地図のように、既に市場を持っている地域と、ここに来て新しい潜在的な地域、市場が現れてきております。

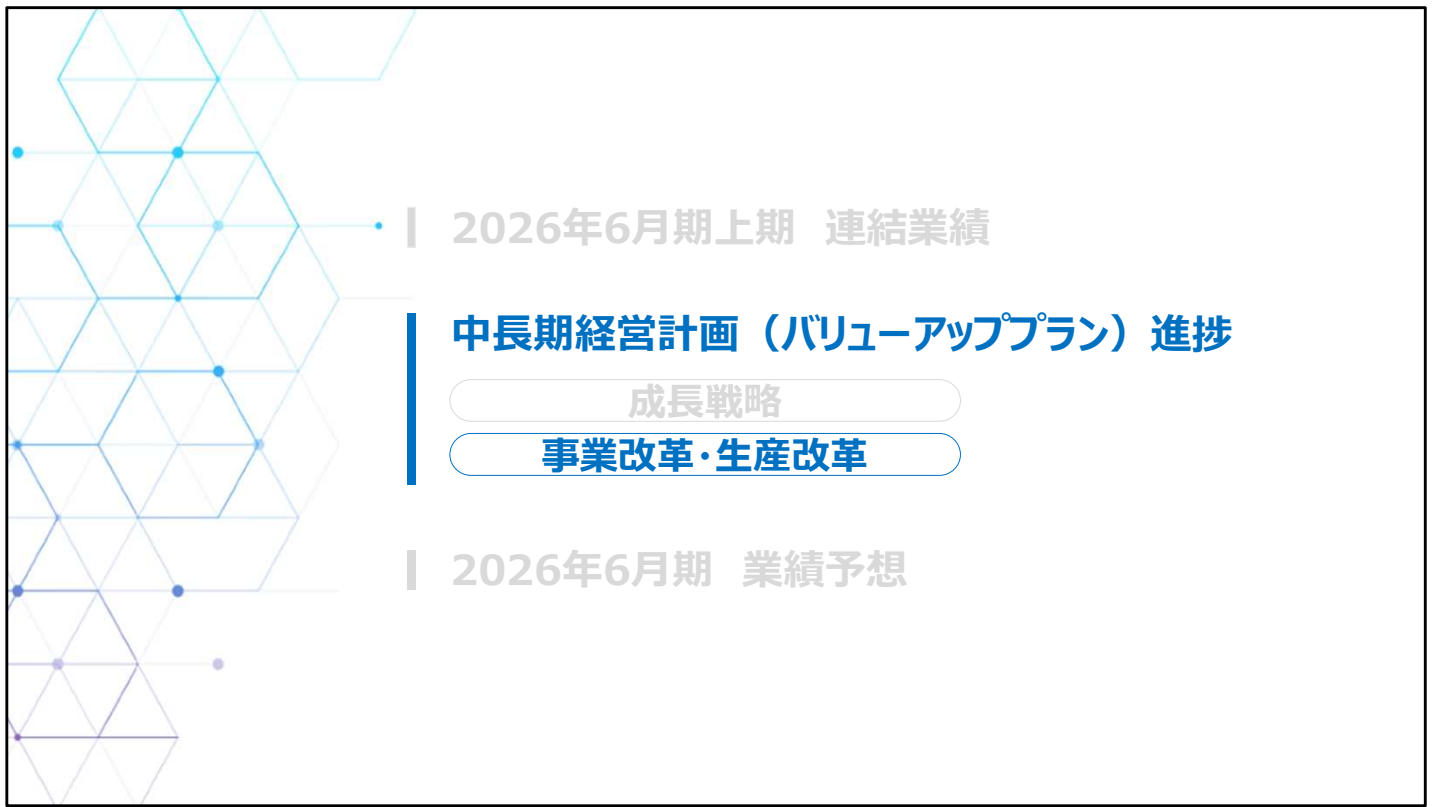
右側に2025年6月、さらには2026年6月期の予想を掲載していますが、1年間でこのレアアースの真空炉については3倍近くの成長を見込み、さらには3~4年後には、年間350億円から450億円規模の受注を当社は狙っています。



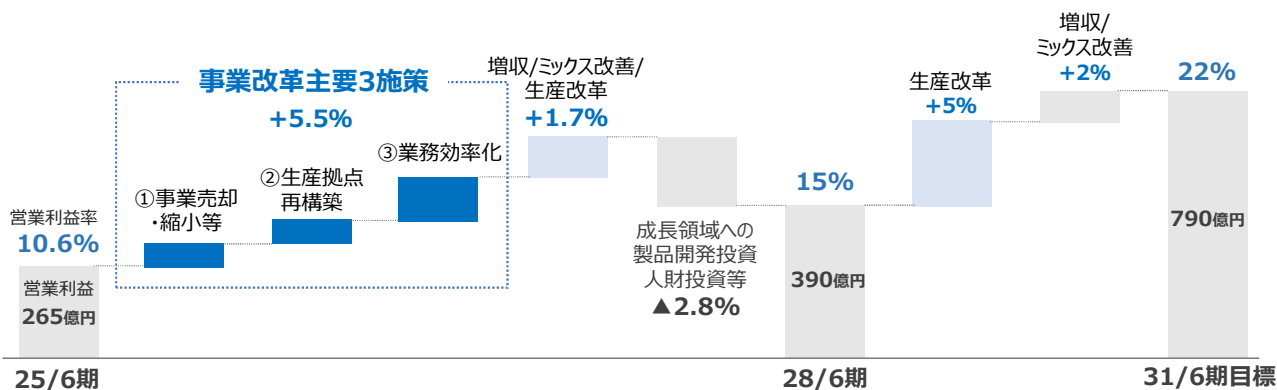
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved | 15

レアースを磁石にするまでの製造工程において、真空溶解の casting 炉、真空焼結炉、真空熱処理炉といったプロセスで、当社は現在、市場の7割近くを有しています。

このビジネスの新たな市場における潜在的なニーズは巨大であると認識しており、ここに経営資源をシフトすることを現在考えています。



続いて事業改革・生産改革の状況です。



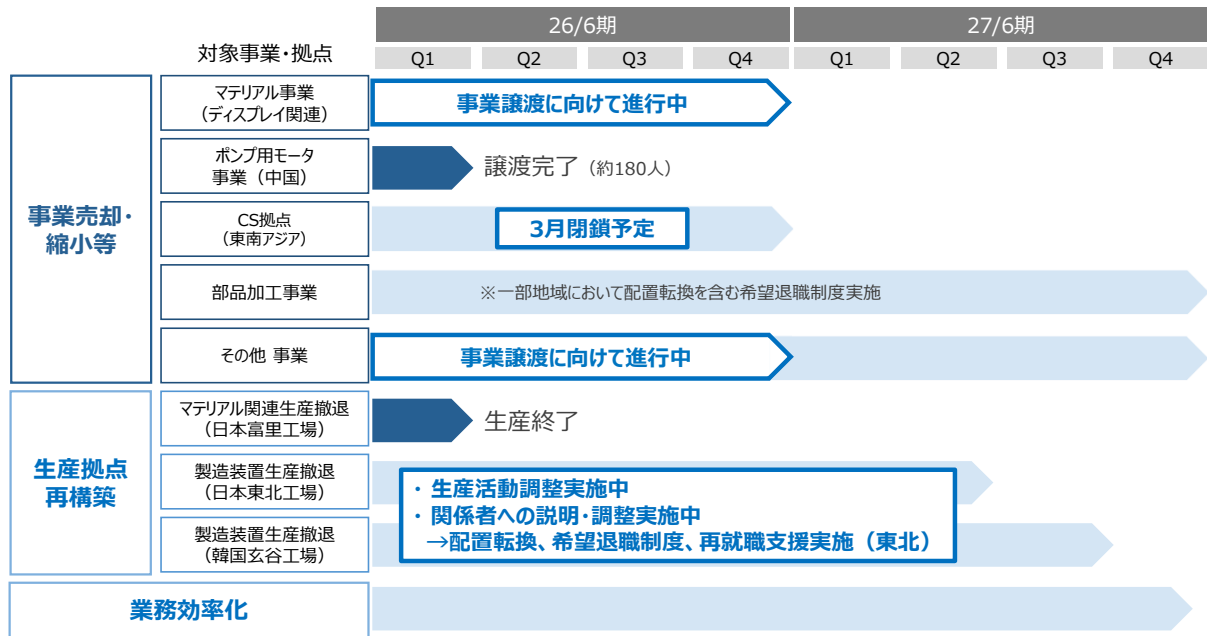
	主要3施策	内容
事業改革	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み、6事業の売却・縮小等を目指す→1事業譲渡完了。 事業譲渡に向けて進行中、CS拠点（東南アジア）：3月閉鎖予定
	② 生産拠点再構築	工場縮小（1拠点・生産終了済） 工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）に向けて対応中
	③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化に向けて対応中
生産改革		MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減：進行中

成長戦略と並行して推進している「事業改革」および「生産改革」についてご説明いたします。本施策は2025年8月に公表した6か年の中長期計画に基づくものです。この2年間で集中改革期間と位置づけ、主要な変革のすべてをスタートさせ、早期の成果創出に注力しております。

事業改革の柱は以下の3点です。

事業売却・縮小等、生産拠点の再構築、業務効率化の徹底

これらの施策を通じ、最終的に営業利益率を5.5%押し上げることを目標として掲げております。



Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

18

現在、各案件は計画通り、あるいは計画を上回るスピードで進捗しております。

マテリアル事業の譲渡：

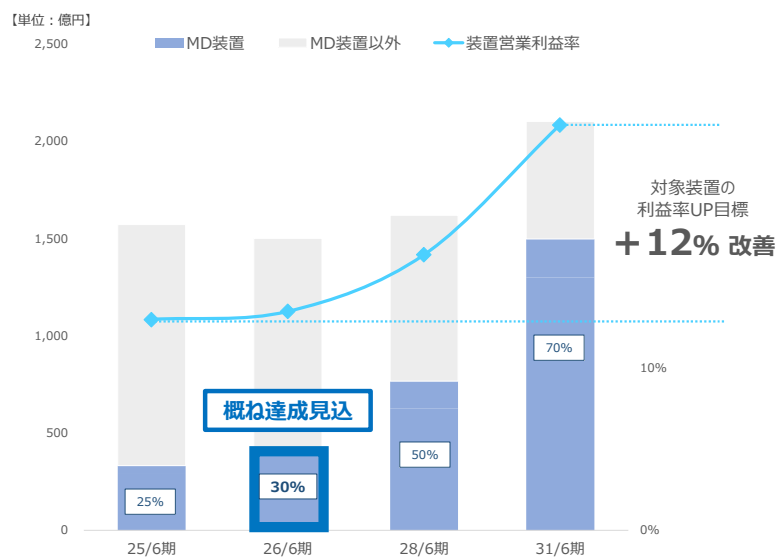
現在手続きを鋭意進めており、当初の予定より前倒しで完了できる見込みです。

CS（カスタマーサービス）拠点：

2026年3月までに一部拠点の閉鎖を完了いたします。

生産拠点の再構築：日本および韓国の国内工場において、関係者や自治体との調整、協議を順次進めており、こちらも滞りなく進行しております。

モジュールデザイン(MD)装置 売上高比率



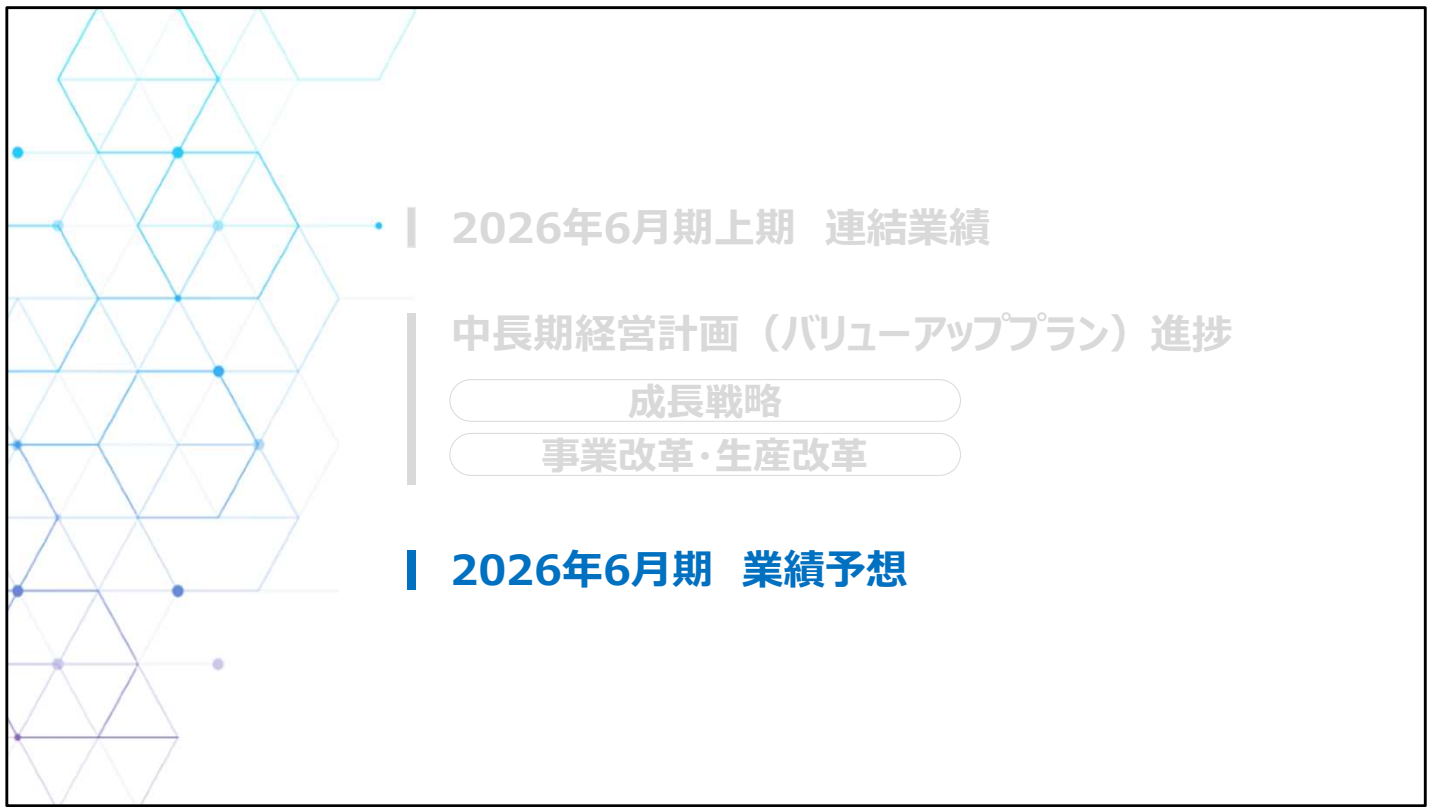
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

19

生産改革においては、従来のパネル事業向けを中心とした個別設計から、今後の主力となる半導体・電子デバイス分野に適した「標準化・モジュール設計」への転換を急いでおります。

標準化の進展： 今期6月までに、対象装置の30%まで標準化を拡大する目処が立ちました。

社内システムの刷新： この変革には社内の仕組みやシステムの抜本的な変更を伴いますが、これも当初の予定を前倒して進めております。



今期の通期業績予想についてです。

2026年6月期 業績予想

- › 受注高：期首計画より+300億円上積みし、過去2番目に高い受注水準となる**2,800**億円を見込む
- › 売上高・各利益(率)：業績予想・配当予想に修正なし、下期にかけて着実な改善を見込む

【単位：億円】	25/6期	26/6期		前期比	
		上期実績	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,371	期首計画 2,500	+244	+11%
			最新予想 2,800	+544	+24%
売上高	2,512	1,239	2,500	-12	-0.5%
売上総利益	799	364	825	+26	+3%
率	31.8%	29.4%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	85	285	+20	+7%
率	10.6%	6.8%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	92	285	-1	-0.4%
率	11.4%	7.4%	11.4%	0.0pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	62	200	+33	+20%
率	6.6%	5.0%	8.0%	+1.4pt	-
1株あたり配当金（円）	164		164		

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

21

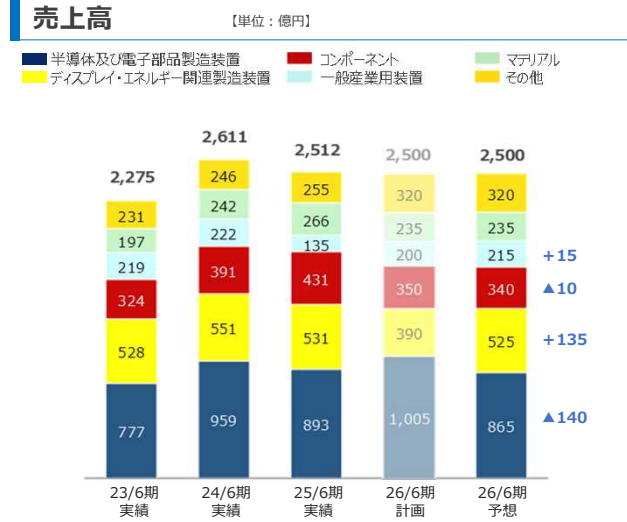
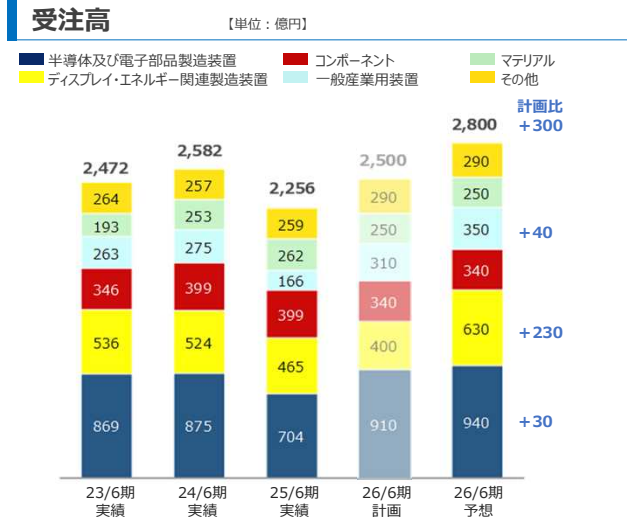
受注高については、期初計画に対して300億円を積み増し、過去2番目の水準となる2,800億円の達成を目指しております。

足元の状況から、この計画は実現の蓋然性が高まっております。一方、売上高および各利益項目については、下期にかけて着実な改善を見込んでおります。

現時点では、通期の業績予想および配当予想を据え置くことといたしました。

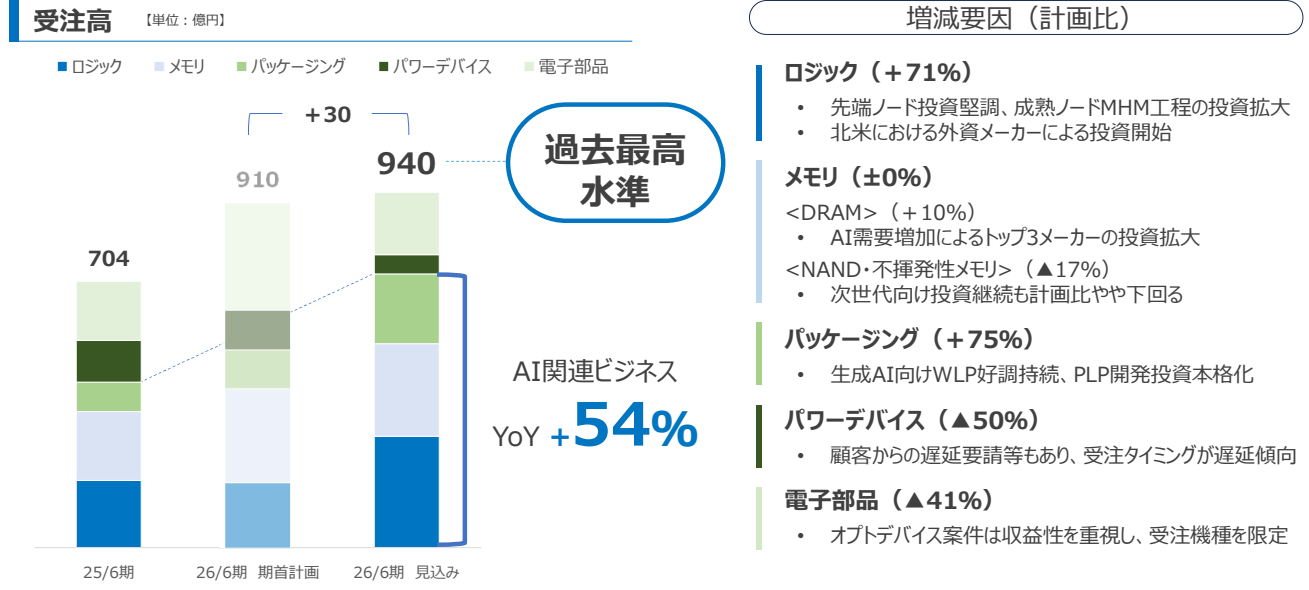
品目別 受注高・売上高予想の修正

- ▶ 受注高：過去最高水準を見込む半導体電子、好調なディスプレイ・一般産業をそれぞれ織り込み2,800億円へ修正
- ▶ 売上高：計画通り2,500億円据え置き、品目内訳の増減反映



受注高の上方修正（+300億円）の内訳は以下の通りです。
 半導体・電子+30億円、ディスプレイ+230億円、一般産業（真空炉）+40億円

売上高に関しては、品目ごとに多少の増減はあるものの、総額としては期首計画通りの2,500億円に向けて進捗しております。



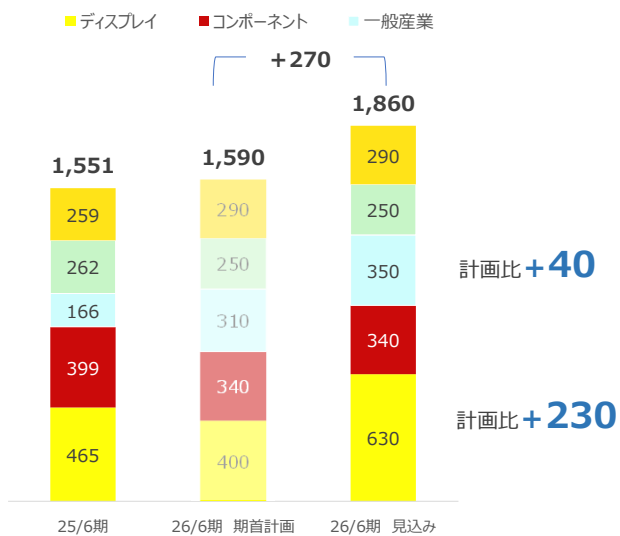
Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

23

成長戦略の中核である半導体・電子分野は、過去最高水準の受注状況にあります。メモリ、パッケージング、パワーデバイスを合わせた受注額は、前年同期比で大幅に伸長いたしました。特にAI関連の成長率は54%増と非常に高い数字を達成しております。

アプリケーション別の動向は以下の通りです。
パワーデバイス 関連市場の停滞も、
ロジック 71%増 (計画比)、パッケージング 75%増 (計画比)

受注高 【単位：億円】



増加要因（計画比）

ディスプレイ（+58%）

- OLED面積拡大化による投資活発化
- LCD・OLEDの設備追加・改造案件による持続的貢献

一般産業（+13%）

- レアアース磁石市場の生産拡大に伴う、投資活発化

ディスプレイおよび一般産業の領域も堅調に推移しており、以下の通り上方修正しております。

ディスプレイ 230億円増（計画比）、一般産業 40億円増（計画比）

品目	投資動向	CY26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> DRAM：AI需要増加によるトップ3メーカー投資拡大 NAND：次世代向け投資継続 ロジック：先端ノード投資堅調、成熟ノードMHM工程の投資拡大、北米における外資メーカーによる投資開始 	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI向けWLP好調持続、Hybrid bonding向け投資期待 PLP開発投資の本格化 光電融合技術の開発加速 	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> 中国大手デバイスメーカー中心に8inchSiC投資の引き合い増加も顧客からの遅延要請等もあり受注タイミング遅延傾向 	
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> OLED面積拡大化による投資増加 設備追加・改造案件による持続的貢献 	
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> 複合集電体への期待が高まるも、依然として市場形成は不透明 銅両面蒸着膜・リチウム膜等の開発継続による中長期的成長期待 	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> 半導体電子等における各種設備投資継続により安定基盤ビジネスとして堅調に推移 レアアース磁石関連の事業拡大の機会到来 	

Copyright© 2026, ULVAC, Inc. All rights reserved

25

各市場の動向を整理すると、明暗が分かれております。

低調な領域 EV関連のパワーデバイスやバッテリービジネスは、依然として停滞が続いています。

好調な領域 AI関連の半導体、パッケージ、各種電子デバイス、ディスプレイ、およびレアアースマグネット分野は、引き続き力強い推移を見込んでおります。

Samsung Electronics社より「功労賞」を受賞

Samsung Electronicsの「Appreciation Day 2025」で功労賞を受賞
製品品質と生産性の向上に貢献した点が評価



TSMC社より「2025 TSMC Excellent Performance Award」を受賞

TSMCより「2025 TSMC Excellent Performance Award」の「Excellent Production Support」を受賞
生産能力拡大や技術協業による優れた生産サポートが評価



SK Hynix社より「Best Partner Award」を受賞

SK Hynixの「2025 Partners Day」で「Best Partner Award」を受賞
スパッタリング装置「ENTRON」が製造工程でPORを取得し、高い技術信頼性などが評価



当社は、Samsung Electronics様、SK Hynix様、TSMC様という世界トップ3社より、栄誉ある賞を同時にいただくことができました。

これは、弊社の半導体製造装置に対する市場からの厚い信頼と、お客様の技術革新における課題解決力が評価された結果であると確信しております。

今後も、これらグローバルパートナーとの連携を深化させ、中長期的な企業価値向上に邁進してまいります。

当社は、以下のとおり希望退職者の募集を開始することをお知らせします。

1. 希望退職者募集の理由

当社グループを取巻く環境は急激に変化しており抜本的な改革を断行するための中長期 経営計画「バリューアッププラン」にて経営資源の最適化、半導体電子中心の事業ポートフォリオの見直しをスタートいたしました。

今後も当社グループが高い競争優位性・生産性を維持し持続的な高成長・高収益性を実現するためには、バリューアッププランで示した基本方針・目指す姿における成長戦略・事業改革・生産改革に取り組む必要があります。それらの実現に向けて配置転換を含めた人員体制の見直しを進めるとともに、従業員一人ひとりの価値観に基づいたライフプランを支援する観点から、今般、希望退職制度を実施することいたしました。

2. 希望退職者募集の概要

- (1) 募集対象者 当社における東北工場、九州工場および同熊本加工センターに属する従業員のうち当社が定める対象者（約170名）
- (2) 募集人員 特に定めない
- (3) 募集期間 2026年2月10日～2026年4月17日
- (4) 退職予定日 2026年6月30日
- (5) 優遇措置 所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。
また、希望者に対しては再就職支援会社を通じて再就職を支援する。

3. 業績への影響

現時点では応募者数および退職金総額等が未確定であるため、業績に与える影響については精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

ULVAC